

ガラスチップ基板

ガラススリミング加工技術により、超薄型化されたガラス電極基板を
任意のサイズに分断いたします。



仕 様

サイズ：10×10mm ~

板 厚：0.05(50 μ m) ~ 0.33 μ m

電極形成：シード層 SP Ti/Cu) + セミアディティブ銅めっき

導 体 厚：0.2 ~ 7 μ m

最小線幅：L/S 5/5 μ m

密 着：1kN 以上